Express Mail Label No.EL631546565US
PATENT
36856.449

### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Keiji SAKATA

Serial No.: Currently unknown

Filing Date: Concurrently herewith

For: MULTILAYER INDUCTOR



# TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of each of Japanese Patent Application No. 2000-035593 filed February 14, 2000, from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55b. Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

Date: February 14, 2001

Christopher A. Bennett Attorney for Applicant(s)

Reg. No. 46,710

KEATING & BENNETT LLP 10400 Eaton Place, Suite 312 Fairfax, VA 22030 (703) 385-5200

# 日本国特許庁





別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 2月14日

出 願 番 号 Application Number:

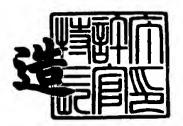
特願2000-035593

出 願 人 Applicant (s):

株式会社村田製作所

2001年 1月26日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office 及川春



# 特2000-035593

【書類名】

1/

特許願

【整理番号】

JP-2002799

【提出日】

平成12年 2月14日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01F 17/00

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

坂田 啓二

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】

100079577

【弁理士】

【氏名又は名称】

岡田 全啓

【電話番号】

06-6252-6888

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

012634

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】 9004879

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層インダクタ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層される複数の磁性体層、および

前記複数の磁性体層間に形成され、前記磁性体層に形成したスルーホールを介 して螺旋状に接続される複数のコイル導体パターンを含む積層インダクタにおい て、

前記磁性体層の主面上における前記複数のコイル導体パターンの1周分の投影面の面積を、前記磁性体層の主面の面積の35%以上75%以下にしたことを特徴とする、積層インダクタ。

【請求項2】 前記磁性体層において前記コイル導体パターンの近傍部分に 非磁性部分が形成された、請求項1に記載の積層インダクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は積層インダクタに関し、特に、たとえばDC/DCコンバータ用の チョークコイルなどとして使用される積層インダクタに関する。

[0002]

【従来の技術】

パソコンのメイン電源などに用いられるDC/DCコンバータでは、直流抵抗が小さく大きな直流電流を流すことができるコイルないしはインダクタが必要となっている。従来、この種のインダクタには、ドラム型のコアに導線を巻いたタイプのものが多く使われている。

[0003]

図10は従来のインダクタの一例を示す図解図である。図10に示すインダクタ1では、ドラム型のコア2に、断面が円形の導線3が巻かれる。

図11は従来のインダクタの他の例を示す図解図である。図11に示すインダクタ1では、ドラム型のコア2に、断面が長方形の導線3が巻かれる。

図12は従来のインダクタのさらに他の例を示す図解図である。図12に示す

インダクタ1では、ドラム型のコア2に、断面が長方形の導線3が巻かれ、さらに、コア2の中央部分すなわち導線3からなるコイルの中心部分に、エアーギャップないしは空洞部分4が形成される。

図11に示すインダクタ1では、図10に示すインダクタ1と比べて、断面が 長方形の導線3が用いられるので、導線3が巻かれるスペースを隙間なく有効に 使えるため、直流抵抗を小さくすることができ、大きな直流電流を流すことがで きるという利点がある。

また、図12に示すインダクタ1では、図11に示すインダクタ1と比べて、 コア2の中央部分すなわち導線3からなるコイルの中心部分に、磁束を切るよう にエアーギャップないしは空洞部分4が形成されるので、インダクタンスの直流 重畳特性が改善される。

#### [0004]

ところが、図10ないし図12に示すインダクタ1では、フェライトからなるコア2と内部の導線3とを同時に加工することができず、たとえば、E型のコアに導線を巻いて、さらに別のE型のコアを重ね合わせるという方法がとられる。この場合、コア同士の接触が十分な面接触とならず、特性の低下やばらつきの原因となる。また、コアなどの加工が複雑なこと、コアを金型で作ること、断面が長方形の導線のコストが高いことなどにより、製品コストが高くなるといった欠点があった。

#### [0005]

そこで、そのような欠点がない積層インダクタが考え出された。特開平10-12443号および特開平10-27712号には、そのような従来の積層イン ダクタが開示されている。

図13は従来の積層インダクタの一例を示す図解図である。図13に示す積層インダクタ5は積層体6を含む。積層体6は積層される複数の磁性体層6aを含み、それらの磁性体層6a間にはコイル導体パターン7がそれぞれ形成される。これらのコイル導体パターン7は、磁性体層6aに形成したスルーホールを介して螺旋状に接続される。また、積層体6の両端部には、外部電極8aおよび8bが形成される。これらの外部電極8aおよび8bは、コイル導体パターン7から

なるコイルの両端に接続される。さらに、積層体6ないしは磁性体層6 a の中央部分すなわちコイルの中心部分には、インダクタンスの直流重畳特性を改善するために、空洞部分9 a が形成される。

図14は従来の積層インダクタの他の例を示す図解図である。図14に示す積層インダクタ5は、図13に示す積層インダクタ5と比べて、積層体6ないしは磁性体層6aの中央部分すなわちコイルの中心部分が、インダクタンスの直流重 畳特性を改善するために、非磁性セラミックス9bで形成される。

図13および図14に示す積層インダクタ5では、図10ないし図12に示す インダクタ1と比べて、加工が複雑にならないので、低コストで作ることができ る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上述の従来の積層インダクタでは、コイル導体パターンの面積が小 さいため、直流抵抗が大きく、大きな直流電流を流すには不向きである。

[0007]

それゆえに、この発明の主たる目的は、直流抵抗が小さく大きな直流電流を流 すことができる積層インダクタを提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

この発明にかかる積層インダクタは、積層される複数の磁性体層と、複数の磁性体層間に形成され、磁性体層に形成したスルーホールを介して螺旋状に接続される複数のコイル導体パターンとを含む積層インダクタにおいて、磁性体層の主面上における複数のコイル導体パターンの1周分の投影面の面積を、磁性体層の主面の面積の35%以上75%以下にしたことを特徴とする、積層インダクタである。

この発明にかかる積層インダクタでは、磁性体層においてコイル導体パターン の近傍部分に非磁性部分が形成されてもよい。

[0009]

この発明にかかる積層インダクタでは、磁性体層の主面上における複数のコイ

ル導体パターンの1周分の投影面の面積を、磁性体層の主面の面積の35%以上75%以下にしたので、複数のコイル導体パターンからなるコイルの直流抵抗が小さくなり、大きな直流電流を流すことができる。

また、この発明にかかる積層インダクタでは、磁性体層においてコイル導体パターンの近傍部分に非磁性部分が形成されると、非磁性部分で磁束が切られるので、複数のコイル導体パターンからなるコイルの近傍部分で磁気飽和が起こりにくくなり、インダクタンスの直流重畳特性が改善される。

#### [0010]

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の発明の実施の形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。

#### [0011]

#### 【発明の実施の形態】

図1はこの発明にかかる積層インダクタの一例を示す図解図であり、図2はその積層インダクタの分解斜視図である。この積層インダクタ10は積層体12を含む。

#### [0012]

積層体12は積層される複数の磁性体層14を含む。これらの磁性体層14間には、第1のコイル導体パターン16a、第2のコイル導体パターン16b、引出しコイル導体パターン16cおよび16dが形成される。この場合、複数の第1のコイル導体パターン16aおよび複数の第2のコイル導体パターン16bが交互に形成される。なお、図1および図2では、第1のコイル導体パターン16aおよび第2のコイル導体パターン16bのうちいくつかのものが省略されている。引出しコイル導体パターン16cおよび16dは、これらの第1のコイル導体パターン16aおよび第2のコイル導体パターン16cは、磁性体層14の一端部にのびる引出し部を有する。また、他方の引出しコイル導体パターン16cは、磁性体層14の一端部にのびる引出し部を有する。さらに、引出しコイル導体パターン16dは、磁性体層14の他端部にのびる引出し部を有する。さらに、引出しコイル導体パターン16cおよび16d間の磁性体層14には、スルーホール18がそれぞれ形成される。そして、上述のコイル導体パターン16a、16b、

16 c および 16 d は、スルホール 18 を介して螺旋状に接続される。

[0013]

また、この積層インダクタ10において、コイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dは、図3に示すように、磁性体層14の主面上における1周分の投影面の面積Scが磁性体層14の主面の面積Smの35%以上75%以下になるように形成される。

[0014]

さらに、積層体12の両端部には、外部電極20aおよび20bが形成される。これらの外部電極20aおよび20bは、コイル導体パターン16cおよび16dの引出し部すなわちコイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dからなるコイルの一端および他端にそれぞれ接続される。

[0015]

この積層インダクタ10を作るためには、たとえば、まず、磁性体層の材料となるグリーンシート上に各コイル導体パターンをスクリーン印刷などの方法で印刷して形成する。そして、第1のコイル導体パターンを形成したグリーンシートおよび第2のコイル導体パターンを形成したグリーンシートを交互に積み重ね、それを引出しコイル導体パターンを形成したグリーンシートで挟み、さらに、その外側をグリーンシートで挟み込んで、積層物を作る。そして、その積層物をプレスし、焼成して、積層体を作り、その積層体に外部電極を形成して、積層インダクタ10を作る。

[0016]

この積層インダクタ10では、磁性体層14の主面上における複数のコイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dの1周分の投影面の面積Scを、磁性体層14の主面の面積Smの35%以上75%以下にしたので、複数のコイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dからなるコイルの直流抵抗が小さくなり、大きな直流電流を流すことができる。

[0017]

なお、磁性体層の主面の面積 S m に対するコイル導体パターンの投影面の面積 S c の面積比率が 3 5 %未満では、コイルの直流抵抗が大きくなり、好ましくな

い。一方、その面積比率が75%をこえると、磁束が回らなくなるため、取得インダクタンスが小さくなり、好ましくない。

[0018]

また、この積層インダクタ10は、上述のような積層的な工法で作ることができるため、巻線を用いたインダクタのように加工が複雑にならず、低コストで作ることができる。

[0019]

さらに、この積層インダクタ10では、一体的に成形されるため、薄型化が容易である。

[0020]

ここで、上述の積層インダクタ10において、円板状の磁性体層14と、磁性体層14の主面上における1周分の投影面がリング状であるコイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dとを用いた場合の電気特性などについて説明する。

[0021]

たとえば、図4に示すように、直径Dが4mmの円板状の磁性体層14と、1周分の投影面の幅方向における中央部分Cが2mmの円でありかつ幅Wが1mmのコイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dとを用いた場合、磁性体層14の主面の面積は12.56mm²となり、コイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dの1周分の投影面の面積は6.28mm²となり、磁性体層14の主面の面積に対するコイル導体パターン16a、16b、16cおよび16dの1周分の投影面の面積比率は50%となる。

上述の例において、高さないしは厚みが1mmである積層インダクタを作ると、10μHのインダクタンスにおいて、直流抵抗は0.2Ω程度となる。

また、上述の例において、コイル導体パターンの幅Wを0.3mmにすると、面積比率は1.5%となり、同じ $1.0\mu$  Hのインダクタンスを取得するのに必要となるコイル導体パターンの巻数は少なくなり、最大取得できるインダクタンスも大きくなるが、 $1.0\mu$  Hのインダクタンスにおける直流抵抗は $0.4\mu$  発度と大きくなる。

さらに、上述の例において、コイル導体パターンの幅Wを変えた場合の各インダクタンスにおける直流抵抗の値を表1に示した。

[0022]

# 【表1】

電極の幅 (mm)		0. 3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5
面積比率(%)		15	25	35	50	60	75
直	5 μ Η の場合	0. 25	0.18	0.14	0.12	0.11	0.11
流	10μΗの場合	0. 39	0. 28	0. 22	0. 20	0. 19	0.18
抵	20μΗの場合	0. 57	0. 41	0. 33	0.30	0. 29	
抗	30μΗの場合	0. 80	0. 56	0. 44			
(Ω)	50μΗの場合	1.04	0.82				

--- は、取得不可を示す。

[0023]

また、この表1をグラフにすると、図5に示すようになる。

[0024]

表1および図5に示すグラフより、コイル導体パターンの幅Wを広げることで、直流抵抗は小さくなるが、徐々にその低下の度合いが小さくなり、面積比率の増加に対する効果は小さくなり、さらに、最大取得できるインダクタンスも小さくなることがわかる。

また、コイル導体パターンの幅Wを広げることで直流抵抗は小さくできるが、 取得できるインダクタンスの領域も考慮すると、上述の例では、30μHまでは 取得できる面積比率を35%以上とする。

[0025]

図6はこの発明にかかる積層インダクタの他の例を示す図解図であり、図7はその積層インダクタの分解斜視図である。図6および図7に示す積層インダクタ10では、図1および図2に示す積層インダクタ10と比べて、1つの第2のコイル導体パターン16bの内側部分に、エアーギャップないしは空洞部分22が形成されている。

[0026]

図6および図7に示す積層インダクタ10は、図1および図2に示す積層インダクタ10と同様にして作られるが、空洞部分22は、グリーンシート上で第2のコイル導体パターンの内側部分に、たとえばカーボンなどの有機ペーストを薄く塗布しておき、全体を焼成することによって形成される。

[0027]

図6および図7に示す積層インダクタ10では、図1および図2に示す積層インダクタ10と比べて、特に、空洞部分22がコイルの中心部分を通る磁束を切るため、コイルの中心部分で磁気飽和が起こりにくくなり、優れたインダクタンスの直流重畳特性が得られる。

[0028]

この空洞部分22は、有機ペーストの塗布厚や塗布部分を変えることによって、大きさや位置を容易に変えることができ、これによって、必要な特性を得ることができる。

[0029]

図8は、空洞部分を形成しない場合、空洞部分を形成した場合および空洞部分を大きくした場合の積層インダクタの電気特性を示すグラフである。図8に示すグラフより明らかなように、空洞部分を形成しない場合より形成した場合のほうが積層インダクタのインダクタンスの直流重畳特性がよくなることがわかり、さらに、空洞部分を大きくした場合にインダクタンスの直流重畳特性がさらによくなることがわかる。

[0030]

なお、有機ペーストを塗布して空洞部分22を形成する代わりに、有機ペーストの塗布部分と同じ大きさの樹脂シートを設けても、コイル導体パターンの近傍部分に非磁性部分が形成されることになり、非磁性部分で磁束が切られるので、コイルの近傍部分で磁気飽和が起こりにくくなり、インダクタンスの直流重畳特性がよくなる。

[0031]

図9はこの発明に積層インダクタのさらに他の例を示す分解斜視図である。図

9に示す積層インダクタ10では、図1および図2に示す積層インダクタ10と 比べて、特に、第1のコイル導体パターン16aおよび第2のコイル導体パター ン16bがそれぞれC字型に形成され、引出しコイル導体パターン16cおよび 16dがそれぞれJ字型に形成されている。このように、コイル導体パターンの 形状を変えても、同様の効果が得られる。

[0032]

# 【発明の効果】

この発明によれば、直流抵抗が小さく大きな直流電流を流すことができる積層 インダクタが得られる。

また、この発明にかかる積層インダクタでは、磁性体層においてコイル導体パターンの近傍部分に非磁性部分が形成されると、インダクタンスの直流重畳特性が改善される。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

この発明にかかる積層インダクタの一例を示す図解図である。

#### 【図2】

図1に示す積層インダクタの分解斜視図である。

#### 【図3】

図1に示す積層インダクタの磁性体層の主面およびコイル導体パターンの投影 面を示す平面図である。

#### 【図4】

磁性体層およびコイル導体パターンの他の例を示す斜視図である。

# 【図5】

図4に示す磁性体層およびコイル導体パターンを用いた積層インダクタの電気 特性を示すグラフである。

#### 【図6】

この発明にかかる積層インダクタの他の例を示す図解図である。

#### 【図7】

図6に示す積層インダクタの分解斜視図である。

# 【図8】

空洞部分を形成しない場合、空洞部分を形成した場合および空洞部分を大きく した場合の積層インダクタの電気特性を示すグラフである。

【図9】

この発明にかかる積層インダクタのさらに他の例を示す分解斜視図である。

【図10】

従来のインダクタの一例を示す図解図である。

【図11】

従来のインダクタの他の例を示す図解図である。

【図12】

従来のインダクタのさらに他の例を示す図解図である。

【図13】

従来の積層インダクタの一例を示す図解図である。

【図14】

従来の積層インダクタの他の例を示す図解図である。

【符号の説明】

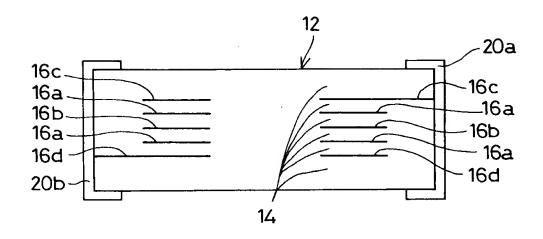
- 10 積層インダクタ
- 12 積層体
- 14 磁性体層
- 16a、16b、16c、16d コイル導体パターン
- 18 スルーホール
- 20a、20b 外部電極
- 22 空洞部分

【書類名】

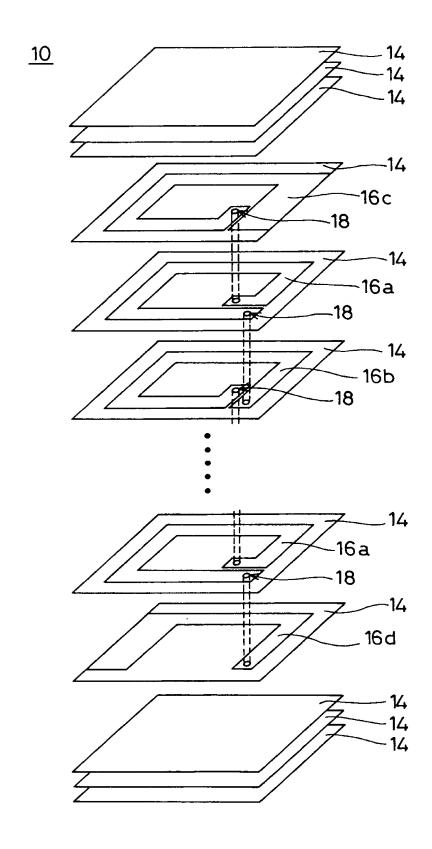
図面

【図1】

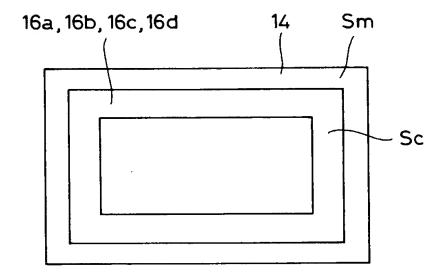
<u>10</u>



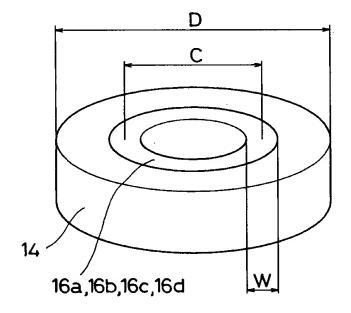
【図2】



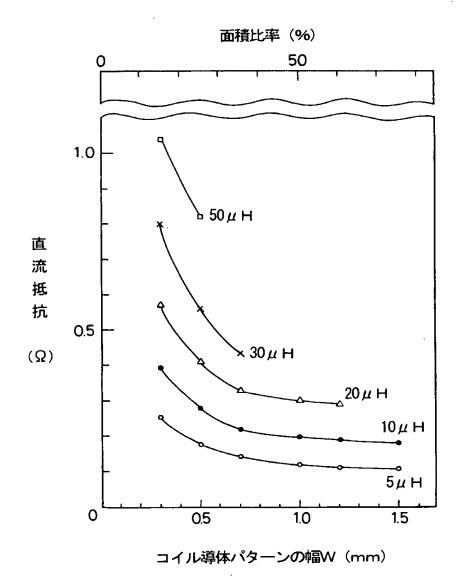
【図3】



【図4】

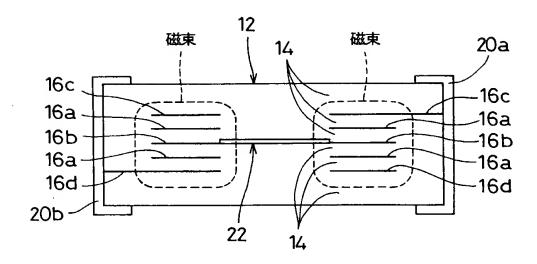


【図5】

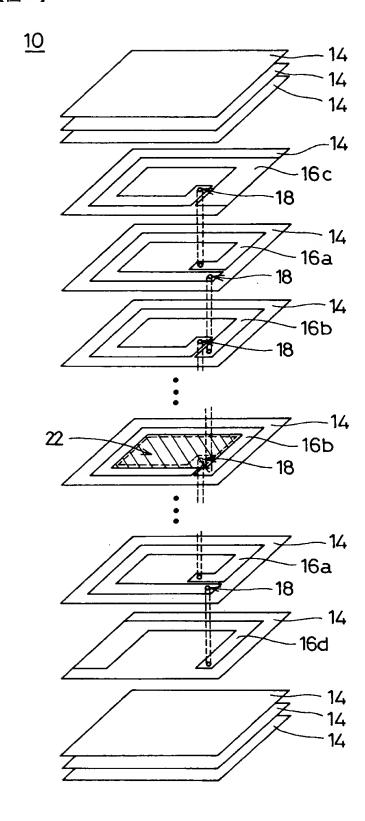


【図6】

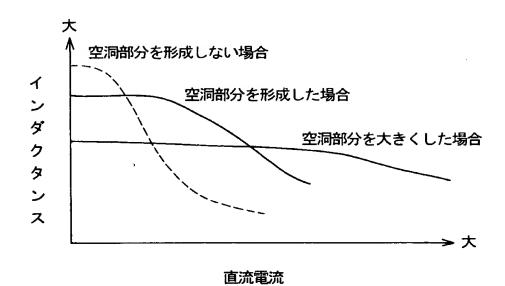
<u>10</u>



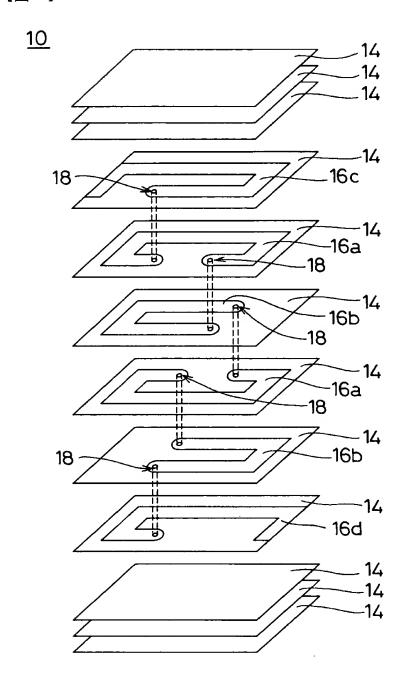
【図7】



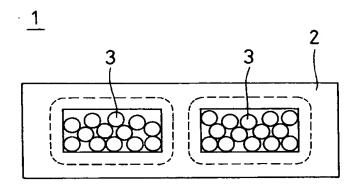
【図8】



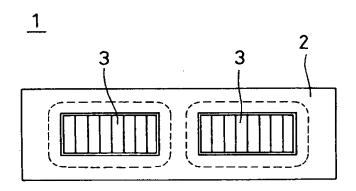
【図9】



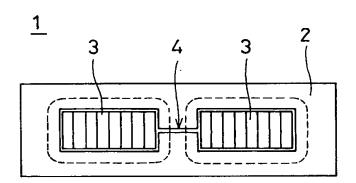
【図10】



【図11】

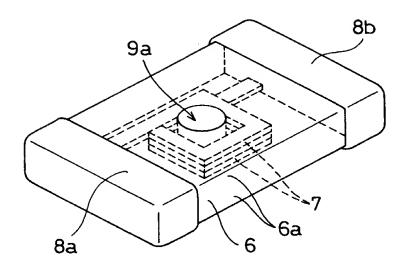


【図12】



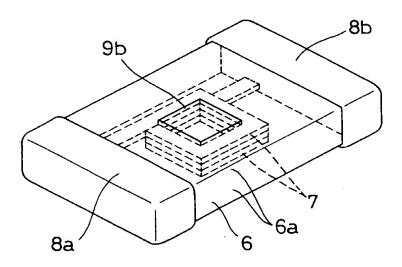
【図13】

<u>5</u>



【図14】

<u>5</u>



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 直流抵抗が小さく大きな直流電流を流すことができる積層インダクタ を提供する。

【解決手段】 積層インダクタ10の積層体12は、積層される複数の磁性体層14を含む。磁性体層14間には、コイル導体パターン16a、16b、16c および16dが形成される。コイル導体パターン16a~16dは、磁性体層14に形成したスルーホール18を介して螺旋状に接続される。コイル導体パターン16a~16dは、磁性体層14の主面上における投影面の面積が磁性体層14の主面の面積の35%以上75%以下になるように形成される。

【選択図】 図1

# 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所